의사결정	토론	리뷰	공유
		•	

ACE향 Si-LiDAR 센서 BM 및 평가 항목

- SPAD <u>센서</u> (Jasper vs Peridot)

보고자	보고자 S-Task 김성만 연구위원/ 최병수 선임	
목 적	Sony Si-LiDAR BM (Jasper vs Peridot) LiDAR 센서 평가 항목 및 Plan	
참석자		

2022. 5. 30



0. 보고 배경



"ACE향 Si-LiDAR 센서 BM 및 평가 항목"을 주제로 ACE 3D 센서 (Jasper vs Peridot) BM 및 센서 동작 이해, SPAD 소자 성능 평가를 바탕으로 LiDAR Calibration 기술 내재화 구축

목차 :

- 1. LiDAR 센서 (Jasper vs Peridot) BM
- 2. Jasper vs Peridot 비교
- 3. 신규센서 Peridot SPAD 분석
- 4. 소니 specific SPAD 소자 구조
- 5. LiDAR 성능 주요 지표
- 6. SPAD 소자 & 성능 연계성
- 7. LiDAR 소자 평가 Plan
- 8. Summary

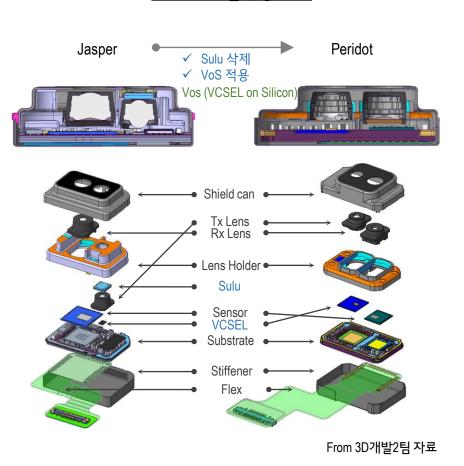
1. LiDAR 센서 (Jasper vs Peridot) BM



- □ ACE向 모바일 LiDAR 모듈인 Jasper/ Peridot에 탑재된 Sony Si-SPAD 센서 비교분석
 - Peridot 센서 Chip Size/ Resolution 축소, PDE 개선을 위한 IPA 구조 적용

PDE (Photon Detection Efficiency) IPA (Inverted Pyramid Array)

Si-LiDAR 모듈 변경 Point



센서 변경 Point

	ACE向 Mobile LiDAR 비교			
과제/센서명	Jasper (IMX592, Periscope)	Peridot (IMX591, Granger)		
Sensor Type	d-ToF 방식 Si-SPAD 센서	←		
Sub. Thickness/ Material	150um/ Silicon	←		
Chip Size	4.20×4.09 mm2	2.77×2.45 mm2		
Resolution	25K 140(H)×180(V)	9K, 84(H)×108(V)		
Pixel Pitch	10.08um	← Direct Bond Interconnect)		
Pixel Structure	BSI/ Cu-Cu Stacked DBI	←		
	1W Shield/ (Backside) Full DTI	←		
	w/o IPA	rench Isolation) w/ IPA (for PDE)		
Epi. Thickness	7.1um	←		
Microscope View	SPAD array FDTI Isolation	SPAD array FDTI Isolation		

2. Jasper vs Peridot 비교

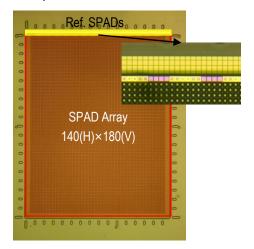


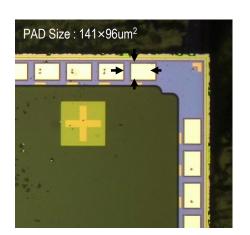
- □ Jasper (IMX592)/ Peridot (IMX591) Chip 변경 점 (Netdie 2.5배 증가 (17.18mm² → 6.79mm²)의 Low cost ver.)
 - ① Reference SPAD array 위치변경 (SPAD Array 상단 → 외부 배치), ② Ref. SPAD 단순화 (2 → 1종류), ③ PAD size 축소 (141×96 → 96×96 um²)
 - → PAD 배치 변경 (Chip Power Route 변경), 소자 Calibration 변경

Jasper (IMX592)

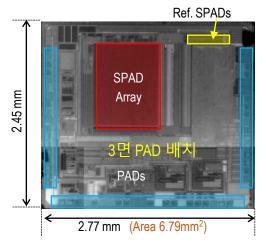
Ref. SPADs SPAD Array 4 년 PAD 배치 PADs 4.20 mm (Area 17.18mm²)

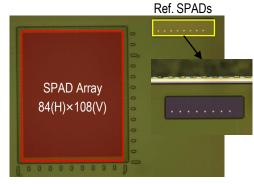
SPAD Pitch: 10.08um Aperture Size (Ref. SPAD) 2.77um, 4.99um

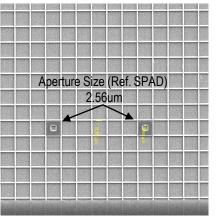


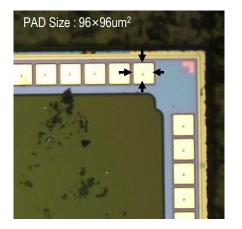


Peridot (IMX591)











2. Jasper vs Peridot 비교



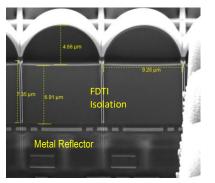
- □ Jasper (IMX592) vs Peridot (IMX591) SPAD의 Microlens, DTI, Reflector 구조의 변경점은 없음
- □ 득이사항 → PDE 성능 개선용 IPA 구조 적용 (Peridot: IMX591)
 - → LiDAR pixel pitch 10um 유지하며, PDE 득성 개선 IPA 구조 도입

Jasper (IMX592)

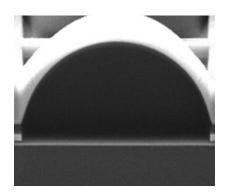
Ref. SPADs SPAD Array 4.20 mm

Cut

Topview) Microlens Array

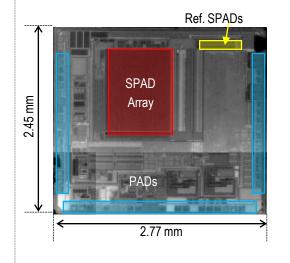


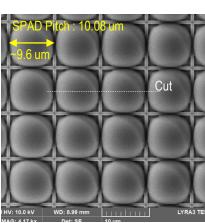
SPAD Profile



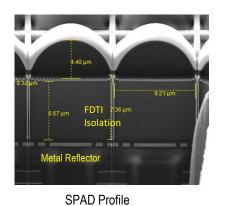
MLA Profile

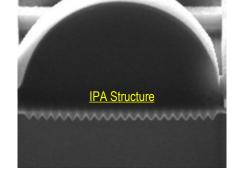
Peridot (IMX591)





Topview) Microlens Array





MLA Profile



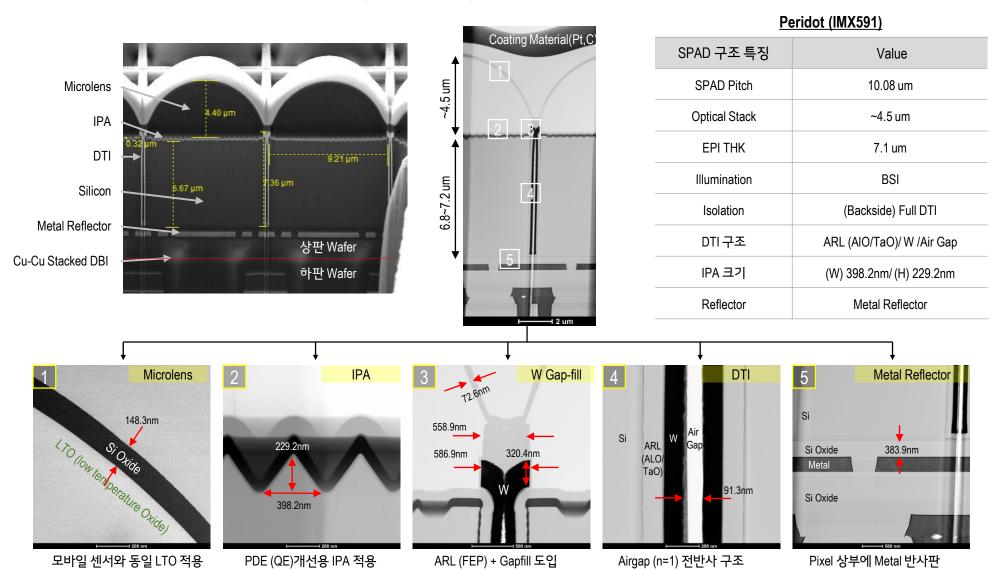
3. 신규센서 Peridot SPAD 분석



□ Peridot (IMX591) SPAD 소자 구조 특징 : BSI, Microlens, IPA, DTI, Cu-Cu Stacked DBI, Reflector etc.

BSI (Backside Illumination)

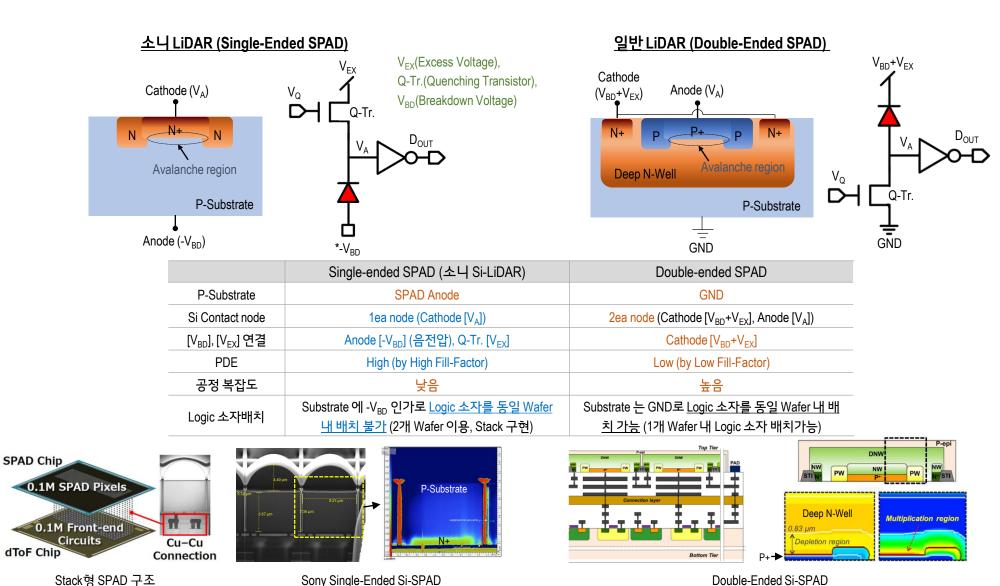
DBI (Direct Bond Interconnect)



4. 소니 specific SPAD 소자 구조



□ 소니 LiDAR 센서는 Single-Ended SPAD 구조 (Stack용 PDE 개선), Single-/ Double-Ended SPAD 특장점 비교



5. LiDAR 성능 주요 지표 I



□ SPAD 소자 지표 (BV, DCR, PDP, PDE, AP) : LiDAR 특성 및 Calibration 인자

PDP (Photon Detection Probability)
PDE (Photon Detection Efficiency)

	T BE (Filotoff Beteation Emotions)			
평가항목	BV (Breakdown Voltage)	DCR (Dark Count Rate)	PDP (PDE = PDP x Fill Factor)	AP (After-pulsing) Probability
Unit	[V]	[cps] or [Hz]	[%]	[%]
Define/ Key Factor	• Avalanche BV효과에 의한 항복 역전압 • PN Junction Profile에 의해 BV 결정	 Dark 조건에서 Thermal 또는 Bias에 의해 1초 동안 발생되는 신호 Pulse 수 BBT, TAT에 의해 유발 BBT (Band-to-Band Tunneling) 	 Illumination 조건에서 Photon에 의해 1초 동안 발생되는 Pulse 수를 통해 계산 입사된 Photon 수 대비 생성된 신호수의 비율로 정의 Pulse[cps] - DCR[cps] # of Photon 	 신호 발생 후 후속으로 특정 Delay를 가지고 발생되는 원치 않는 신호 Silicon 내 Junction의 Deep Trap에 의해유발
Measurement	 Diode의 IV Test (역 전압)으로 평가 또는 SPAD 인가 전압 조정을 통해 출력을 확인하여 유추 	TAT (Trap-Assisted Tunneling) • 디지털 오실로스코프로 SPAD 과도응답 확인을 통한 평가 • 또는 센서 ROIC의 Counter 출력 값 확인	←	• 발생된 Pulse 신호 간 시간 간격에 대한 Histogram을 통해 평가
Result & Analysis Factor	### 10-12 ####################################	• Temp., V _{EX} 에 증가에 따라 DCR이 Exponential 하게 증가하는 관계이기	• # of Photon의 기준에 따른 분류 PDP (Active Area 기준)	• Junction 내 Deep Trap이 많을 수록 AP Probability 증가하며, 센서공정의
	평가 요소 중 하나임	때문에 DCR 평가 시 조건 확인이 필 수임	PDE (Pixel Area 기준) • V _{EX} 증가에 따라 PDP (PDE) 가 증가 경향	Quality에 의존

5. LiDAR 성능 주요 지표 II



□ SPAD 소자 지표 (Emission, Dead time, Jitter, Xtalk) : LiDAR 특성 및 Calibration 인자

평가항목	(Light) Emission	Dead Time	Jitter	Xtalk
Unit	-	[us] or [ns]	[ps]	[%]
Define/ Key Factor	 Junction의 Active 영역에서 Avalanche 에 의한 Breakdown이 정상적이나, Edge 영역에서 Premature Breakdown 발 생 여부를 판별 	 하나의 신호가 검출되고 다음 광자를 검출하기 위해 필요한 시간 Recovery Time 이라고도 지칭함 	• 검출된 신호를 전기신호로 발생시키는 과정에서 발생하는 시간지연	• 하나의 SPAD에 입사된 광이 인접한 다 른 SPAD에 영향을 주는 비율
Measurement	• SPAD에 역전압을 인가한 상태에서 Emission Test를 통해 확인	 SPAD 구성 물질, 회로에 의존하며, 측정을 위한 회로 설계 필요 High Bandwidth의 오실로스코프를 통해 측정 	←	• 인접한 SPAD에 Optical Blocking 층을 형 성하고, 인접한 SPAD 신호를 통해 Cross Talk 평가함
Result & Analysis Factor	Emission 발생영역 Active • Emission 발생영역을 통해 Active/ Edge Breakdown 판별 • Active 영역 Breakdown일 경우 원형, Edge 영역 Breakdown일 경우 도넛모 양을 띰	Vop Rq Vop Photon Arrival Pead Time SPAD Install Proceedings recharge • 수(십) [ns] 수준이며 SPAD의 Active 면적과 주변 회로의 R,C 성분에 의존	Timing Jitter 1.0E-01 1.0E-02 1.0E-03 2.3E-09 Time /s • 수(십) [ps] 수준으로 SPAD의 동작속도에 영향 • V _{EX} 증가에 따라 Jitter 는 감소 경향성	* Cross Talk은 Electrical/ Optical 성분으로 나뉨 * SPAD 간 Isolation 기술로 Cross Talk 감소 경향성

6. SPAD 소자 & 성능 연계성



□ Peridot (iMX591) 센서 구조 및 SPAD 센서 성능 연계성

PDE (Photon Detection Efficiency)

Microlens 영역

■ 관련 성능 : <u>PDP(E)</u>

- Fill Factor는 100%로 PDP와 PDE가 동일 하며, PDP(E) 증가를 위해 Microlens는 Junction에 집광 역할

DCR (Dark Count Rate)

Silicon 영역

■ 관련 성능 : DCR, PDP(E)

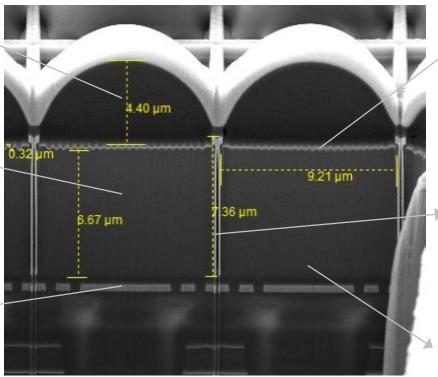
- Silicon Quality가 DCR에 영향을 주며, NIR 940nm 영역대의 PDP(E) 증가를 위해 Silicon Epi. 두께는 모바일 센서에 비해 7.1um 로 상 대적으로 두꺼움

Reflector 영역

■ 관련 성능 : PDP(E)

- NIR 940nm 파장대역에서의 광은 Silicon 투과 율이 높기 때문에 투과된 광을 수집하기 위한 기술이며 PDP(E) 향상을 위한 역할

Peridot (IMX591) SPAD Pixel Profile



IPA (Inverted Pyramid Array)

IPA surface 영역

■ 관련 성능 : PDP(E)

- PDP(E) 향상을 위해 NIR 940nm 파장대의 광경로를 길게 가지고 가기 위한 구조

DTI (Deep Trench Isolation)

DTI interface 영역

■ 관련 성능 : DCR, PDP(E), Xtalk

- 인접 SPAD로 광이동을 막아 Cross Talk 감소 와 PDE 향상에 대한 역할이며, Etch 공정에 따 른 Damage 가 DCR에 영향을 주어 Hole Accumulation으로 DCR 감소 기술이 필요

> BV (Breakdown Voltage) AP (Afterpulse)

<u>Junction 영역</u>

■ 관련 성능 : <u>BV, DCR, PDP(E), AP,</u> Emission, Dead Time, Jitter

- PN Junction의 Profile에 의해 BV, DCR, PDP, Emission 성능에 영향을 주고 물질/ 공정/ 회로에 따라 AP, Dead Time, Jitter 성능에 영향

7. LiDAR 소자 평가 Plan



- □ LiDAR Calibration 기술 및 LiDAR 기술 내제화를 위한 SPAD 소자 평가 System 구축
 - SPAD 소자 평가 (KIST 산연 추진/ 연구소 평가 환경 구축)
 - 4x4 array LiDAR (Skhynix 센서, 평가 ~3Q), Compound LiDAR (Amber 센서, 평가 ~4/Q), 소니 차량 LiDAR (평가 ~4/Q) 진행중



7. Summary



요약 :

- Jasper (IMX592) vs Peridot (IMX591) 비교로 ACE향 Si-LiDAR 센서 변경 점 파악
- Peridot의 소니 specific SPAD 소자 구조의 특이점 분석
- SPAD 소자 성능 평가 항목 List-up
- SPAD 구조 및 성능과의 상관관계 분석

계획:

- SPAD 성능 평가를 위한 LGIT 내 환경 구축
- 성능 평가를 바탕으로 LiDAR Calibration 기술 내재화
- LiDAR 센서 평가 plan

(4x4 array @SKhynix → Si-LiDAR (@소니 IMX459) → Compound-LiDAR (@Amber) 영역확대)



EOD

